

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年2月2日(02.02.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/008207 A1

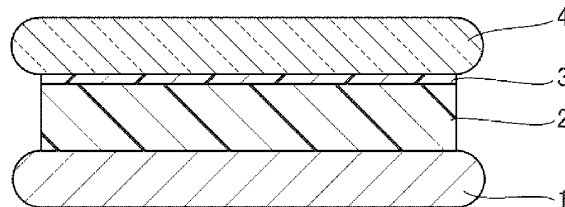
- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C09J 183/07 (2006.01)
C09J 5/04 (2006.01) H01L 21/02 (2006.01)
C09J 183/05 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/027659
- (22) 国際出願日: 2022年7月14日(14.07.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-121582 2021年7月26日(26.07.2021) JP
- (71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 奥野 貴久 (OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635日

産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 臼井 友輝 (USUI Yuki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也 (SHINJO Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).

- (74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 I P特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,

(54) Title: LAYERED BODY MANUFACTURING METHOD, AND KIT FOR ADHESIVE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 積層体の製造方法、及び接着剤組成物のキット



(57) Abstract: This layered body manufacturing method includes: a step in which a first adhesive coating layer is formed on a surface of a release agent coating layer formed on a surface of a support substrate; a step in which a second adhesive coating layer is formed on a surface of a semiconductor substrate; and a step in which bonding and heating of the first adhesive coating layer and the second adhesive coating layer are performed, and a release layer and an adhesive layer are formed. The first adhesive coating layer is formed from a first adhesive composition, and the second adhesive coating layer is formed from a second adhesive composition. One of the first adhesive composition and the second adhesive composition contains a first thermosetting component and a second thermosetting component that reacts with the first thermosetting component in the presence of a catalyst. The other of the first adhesive composition and the second adhesive composition contains the catalyst.

(57) 要約: 支持基板の表面に形成された剥離剤塗布層の表面に第1の接着剤塗布層が形成される工程と、半導体基板の表面に第2の接着剤塗布層が形成される工程と、第1の接着剤塗布層と第2の接着剤塗布層との貼り合せ及び加熱が行われ、剥離層及び接着層が形成される工程と、を含み、第1の接着剤塗布層が、第1の接着剤組成物から形成され、第2の接着剤塗布層が、第2の接着剤組成物から形成され、第1の接着剤組成物及び第2の接着剤組成物の一方が、第1の熱硬化成分と、触媒存在下で第1の熱硬化成分と反応する第2の熱硬化成分とを含有し、他方が、触媒を含有する、積層体の製造方法。

[続葉有]

WO 2023/008207 A1

KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))